Zn 掺杂 p 型 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}笼合物的 合成及热电性能*

邓书康 唐新峰 计张清杰

(武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室,武汉 430070)
 (2006年11月14日收到2007年1月22日收到修改稿)

用熔融法结合放电等离子烧结方法合成了 Zn 掺杂单相 p 型 Ge 基 I 型笼合物 Ba₈ Ga₁₆ Zn_x Ge_{30-x}(x = 3, 4, 5, 6),探索 Zn 取代 Ge 对其热电性能的影响规律 结果表明 :所制备的 Ba₈ Ga₁₆ Zn_x Ge_{30-x}化合物为 p 型传导 随 Zn 取代 量 x 的增加 ,化合物室温载流子浓度 N_p 逐渐增加 ,室温载流子迁移率 μ_H 和电导率逐渐降低 . 在所有试样中 , Ba₈ Ga₁₆ Zn₃ Ge₂₇化合物的 Seebeck 系数 α 在 300—870 K 内始终最大 ,温度为 300 K 时 Seebeck 系数为 234 μ V/K ,在 700 K附近达 295 μ V/K. 化合物的热导率随 Zn 取代量 x 的增加而降低 . Ba₈ Ga₁₆ Zn₃ Ge₂₇ 化合物在 806 K 最大 ZT 值 达 0.38.

关键词:p型笼合物,合成,热电性能 PACC:8120,7215,7430F

1.引 言

热电材料作为一种新能源材料,近几年来已成 为国内外研究的热点.热电材料的性能可用无量纲 热电性能指数 *ZT* 表示,*ZT* = $\alpha^2 \sigma T/\kappa$,其中 α 为 Seebeck 系数, σ 为电导率, κ 为热导率,*T* 为绝对温 度.尽管近 30 年来热电材料的 *ZT* 值有较大的提 高,但实用块体热电材料的最大 *ZT* 值仍然在 1 左 右.近年来,为寻求具有较高 *ZT* 值的热电材料,很 多研究都集中在那些具有复杂晶体结构的化合物, 如填充式方钴矿化合物¹⁻⁶1和笼合物⁷⁻⁹1等.

且型 Ge 基笼合物由于具有声子玻璃-电子晶体 (PGEC)的特征,作为一种具有潜在应用前景的热电 材料引起了人们广泛关注. Ⅱ型笼合物的一般通式 为 $A_8^{II} B_{16}^{II} B_{30}^{II}$ (A^{II} = Ba Sr 等, B^{III} = Al ,Ca ,In 等, B^{III} = Si ,Ge Sn 等),元胞中包含由 B^{IIII} 和 B^{III} 原子构成 的 6 个十四面体和 2 个十二面体,十四面体和十二 面体之间通过共面连接,多面体内填充碱土金属原 子,由于其在"笼子"内振动,从而对声子产生散射, 降低晶格热导率,另一方面,框架结构通过 B^{III} - B^{III} 原子的 sp³ 杂化,使其具有较好的电性能,因而可望 得到较高的 ZT 值.迄今为止关于 n 型 Ge 基笼合物 的研究报道较多.Kuznetzov 等^[10]将化学计量比的高 纯金属置于内沉积碳膜的氧化铝坩埚中熔融反应得 到的 n 型 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀笼合物在 700 K 时 ZT 值为 0.7. Saramat 等^[11]用 Czochralski 法生长的具有 n 型 传导的 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀笼合物在 900 K 时 ZT 值为 1.35. 但由于在设计热电器件时同时需要 n 型和 p 型热电 材料,国内外对 p 型笼合物的研究也刚刚起 步^[12—14],其工作主要集中在笼合物结构及低温区 域的性能研究,有关 p 型笼合物在中高温区域的热 电传输特性的研究尚未见报道.本文以 Zn 作为掺杂 原子,通过 Zn 对 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀结构中 Ge 位的取代制 备具有 p 型传导的 I 型 Ge 基笼合物,研究 Zn 掺杂 对化合物热电传输特性的影响规律.

2. 制备与测试

起始原料为高纯块状 Ba(99%),块状 Ga (99.99%),块状 Ge(99.99%)和粒状 Zn(99.999%) 按化学式 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}(x=3 A 5 6)称量(其中

^{*} 国家自然科学基金重大国际合作项目(批准号 50310353)和教育部科技创新工程重大项目培育基金(批准号 :705035)资助的课题.

[†] E-mail:tangxf@whut.edu.cn

Ba 的化学计量按 8.3 配料),置于内壁预先沉积碳 化膜的石英管中,真空密封,以 300 K/h 的速度升温 到 1323 K,保温 5 h,随炉冷却到室温.最后以得到的 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物粉末为原料,用放电等离子 烧结(SPS)方法于真空下烧结,烧结温度和时间分别 为 1023 K和 480 s,压力为 40 MPa,得到相对密度大 于 98%的致密块体.

试样的相组成在日本理学公司生产的 D/Max-III型 X 射线衍射(XRD)仪(Cu Kα 射线)通过粉末 XRD 法确定.室温下霍尔系数 $R_{\rm H}$ 、电阻率 ρ 、载流子 (空穴)浓度 $N_{\rm p}$ 及载流子迁移率 $\mu_{\rm H}$ 用 van der Pauw 方法在英国 Accent Optical 公司生产的 HL5500PC 型 霍尔效应测量系统上同时测得.电导率及 Seebeck 系数在日本真空理工株式会社生产的 ZEM-1 型热 电性能测试系统上同时测得.试样的定压热容 $C_{\rm p}$ 和热扩散系数 λ 用激光微扰法在日本真空理工株式 会社生产的 TC-7000 型激光热常数测试仪测得,热 导率通过公式 $\kappa = C_{\rm p}\lambda d(d$ 为密度)计算,测试温度 为 300—870 K.

3. 结果及讨论

3.1. $Ba_8Ga_{16}Zn_xGe_{30-x}$ 化合物的结构分析

图 1 为熔融后通过 SPS 方法烧结样品的粉末 XRD 谱. 从图 1 可见,所制备的样品均为单相的具 有空间群为 pm3n 的简单立方结构,当取代量 x = 5



图 1 反应产物在熔融并通过烧结后的 XRD 谱

时对应样品的 XRD 谱中(222)峰强于(320)峰.在 I 型笼合物中(222)峰与(320)峰的强度比 I_{222}/I_{320} 依 赖于 Ga 在框架上的占据情况^[15].当 Ga 在框架上随 机分布时(320)峰相对较强,当 Ga 在框架上优先占 据 6c 位置时(222)峰较强.在本试验中,当 Zn 的取 代量 x = 5时,所对应样品中 Ga 在框架上可能也优 先占据晶体学 6c 位置,而其余样品中 Ga 在框架上 随机分布,原因有待于进一步研究.

3.2. $Ba_sGa_{16}Zn_xGe_{30-x}$ 化合物的电性能

表 1 所列为 $Ba_{a}Ga_{16}Zn_{x}Ge_{30-x}$ 化合物在名义组 分下的室温电阻率 ρ 、霍尔系数 $R_{\rm H}$ 、载流子浓度 $N_{\rm p}$ 和载流子迁移率 μ_н.所有试样的霍尔系数均为正 值 因此 $Ba_8Ga_{16}Zn_*Ge_{30-*}$ 化合物表现为 p 型传导. 样品的室温载流子浓度较 n 型 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀(6.8× 10^{20} cm^{-3})⁹]低. 随 Zn 取代量 x 的增加 ,载流子浓度 逐渐增加,载流子迁移率 μ_н逐渐降低.例如,当 Zn 的取代量 x = 3 时,对应样品的载流子浓度 $N_n =$ 3.56×10¹⁸ cm⁻³ ,载流子迁移率 µ_H = 99.7 cm²/Vs ,当 Zn 的取代量增加到 x = 6 时,对应样品的载流子浓 度 N_p 增加到 4.74×10¹⁹ cm⁻³ ,载流子迁移率 μ_H 降 低到 3.09 cm²/Vs.由于室温载流子迁移率的降低, 从而导致室温电阻率逐渐增加.例如,当 x 从 3 增加 到6时,对应的室温电阻率从17.6 mΩcm 增加到 42.7 mΩcm. 由于 Zn 原子的最外层电子数为 2 Ge 原 子的最外层电子数为4,Ga原子的最外层电子数为 3 Zn 在框架上可能取代 Ge 位,也可能取代 Ga 位, 即 Zn 可能与 Ge 成键,也可能与 Ga 成键,但最终的 结果都将在结构中引入空穴 且随掺杂量的增加 空 穴浓度逐渐增加.但由于 Zn 的离子半径比 Ge 的大, 当 Zn 的取代量增加时 ,晶格畸变变大 ,晶格缺陷对 载流子的散射作用增强,从而导致电阻率增加.与 n 型 $Ba_8Ga_{16}Ge_{30}$ 化合物^[9]相比,p 型 $Ba_8Ga_{16}Zn_xGe_{30-x}$ 化合物的载流子迁移率较高.例如 Bag Gal6 Zn3 Ge27 样 品室温下载流子迁移率为 99.7 cm²/Vs,而 n型 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀室温下的载流子迁移率为 14 cm²/Vs ,因 此导致 Bas Gate Zn, Geso-, 化合物电导率较低的主要 原因是载流子浓度较低。

图 2 所示为 $Ba_{8}Ga_{16}Zn_{x}Ge_{30-x}$ 化合物的电导率 σ 与 Zn 取代量 x 和温度 T 的关系.从图 2 可以看出, 所有样品的电导率 σ 在温度较低(T < 700 K)时随 温度的升高而增大,达到一极值后随温度的升高而 略有降低,然后又逐渐增大.这是因为温度较低时本 征激发可以忽略,载流子主要由杂质电离提供,它随 温度的升高而增加,散射主要由电离杂质决定,迁移 率也随温度的升高而增大,所以电导率随温度的升 高而增大.温度继续升高,杂质已全部电离,本征激 发还不十分明显,载流子基本上不随温度变化,晶格 散射成为主要的散射机制,迁移率随温度的升高而 降低,电导率随温度的升高而降低.温度再继续升 高,本征激发很快增加,大量本征载流子的产生远远 超过因迁移率降低对电导率的影响,杂质半导体的 电导率将随温度的升高而急剧增加,表现出与本征 半导体相似的特征. $Ba_8Ga_{16}Zn_xGe_{30-x}$ 化合物在 300—870 K内表现出较低的电导率,如在整个温度 范围内电导率最高的样品 $Ba_8Ga_{16}Zn_3Ge_{27}$ 在室温附 近的电导率约为 5.2 × 10³ S/m,在 870 K 处约为 9.6 × 10³ S/m.

试样编号	名义组成	电阻率 $\rho/m\Omega cm$	霍尔系数 $R_{\rm H}/{\rm cm}^3 \cdot {\rm C}^{-1}$	载流子浓度 $N_{\rm p}/10^{18}{\rm cm}^{-3}$	载流子迁移率 $\mu_{\rm H}/{ m cm}^2 \cdot { m V}^{-1}{ m s}^{-1}$
1	$Ba_8Ga_{16}Zn_3Ge_{27}$	17.6	+ 1.755	3.56	99.70
2	$\operatorname{Ba}_8\operatorname{Ga}_{16}\operatorname{Zn}_4\operatorname{Ge}_{26}$	21.8	+ 0.976	6.32	45.40
3	$Ba_8Ga_{16}Zn_5Ge_{25}$	25.3	+ 0.542	11.3	21.86
4	$\operatorname{Ba}_8\operatorname{Ga}_{16}\operatorname{Zn}_6\operatorname{Ge}_{24}$	42.7	+ 0.130	47.4	3.090





图 2 Zn 取代量 *x* 和温度对 Ba₈ Ga₁₆Zn_x Ge_{30 - x}化合物电 导率的影响

图 3 所示是 Ba_sGa₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物的 Seebeck 系数 α 与 Zn 取代量 x 和温度 T 的关系.从图 3 可以 看出,所有样品的 Seebeck 系数均为正值,表现为 p 型传导,这与室温霍尔系数的测量结果一致.样品的 Seebeck 系数 α 随 Zn 取代量 x 增加逐渐降低,当 Zn 的取代量 x = 3 时所对应样品的 Seebeck 系数在整 个测试温度区间内始终最大,室温 Seebeck 系数为 234 μ V/K,在 700 K 附近达 295 μ V/K.随温度的升 高,所有试样的 Seebeck 系数都呈现先增加,在 700 K 附近达最大值后又逐渐降低,这是因为高温下本 征激发载流子参与传导,材料的绝对温差电动势逐 渐降低.随 Zn 取代量 x 的增加,试样的 Seebeck 系 数逐渐降低,且最大值向低温方向移动,一般而言, Seebeck 系数随载流子浓度的增加而降低.在本研究 中,当 Zn 取代量增加时,载流子浓度逐渐增加,从而 Seebeck 系数逐渐降低. 随 x 的增加 Seebeck 系数最 大值向低温方向移动,可能是因为随 Zn 取代量 x 的增加,样品的能隙 E。逐渐变小,本征激活能逐渐 降低,从而使本征激发温度逐渐降低.在所有试样 中 $_{Ba_8}Ga_{16}Zn_3Ge_{27}$ 的功率因子 $P(P = \alpha^2 \sigma)$ 最大 ,在 700 K 附近为 0.67 × 10⁻³ W/mK². 由此可见 , 型传 导的 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x} 笼合物的 Seebeck 系数较高, 但电导率较低.目前国外所报道的 p 型传导] 型笼 合物的电导率都比较低. Nicolas 等^{13]}用高频感应熔 炼方法在 900 ℃退火 120 h 得到 Au 掺杂具有 I 型笼 合物结构的 p型 Ba₈Au_xSi_{46-x}(x = 5.4)化合物其室温 电导率为 1.0 × 10³ S/m 室温 Seebeck 系数为 32 μV/K. Latturner 等^{12]}用 GaSb 取代 BagGa₁₆Gen 中的部分 Ge 得 到 p 型传导的 I 型笼合物 其室温附近 Seebeck 系数 为 100 µV/K 电导率为 8800 S/m. 最近 Kishimoto 等^{14]} 用 SPS 法合成的 p 型 Ge₃₀ P₁₆ Te₈ 笼合物 其室温电导 率约为 1.0 S/m 在 800 K 附近为 8000 S/m 最大功率 因子在 600 K 处为 0.1 × 10⁻³ W/mK².

电荷平衡的 Zintl 相化合物(如 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀ 笼合物)应该表现为半导体行为,框架内的碱金属原子提供的电子填充在由 Ga 和 Ge 构成的框架上电子空缺处,当用 Sb 进行掺杂时所得到的化合物应该表现为 n 型传导. Latturner 等^[12]认为:Ba₈Ga₁₆Ge₃₀化合物在 框架上存在未被电子填充的空缺能带,从而控制电子的传输,如果在框架上引入缺陷或掺杂将对化合



图 3 Zn 取代量 x 和温度对 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物 Seebeck 系数的影响

物的电传输特性产生较大的影响.当用 Sb 取代框架 上的 Ge 时,导致空缺能带被填充,化合物的导电只 能通过更高能带进行,从而导致较低的电导率.因 此,我们认为当用 Zn 取代 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀中的部分 Ge 时,其对化合物电导率的影响与用 Sb 取代框架上的 Ge 类似.

3.3. Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物的热性能

图 4 为 p 型 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物热导率 κ 和 Zn 取代量 x 及温度的关系.从图 4 可以看出,随着 x 的增加,化合物的热导率逐渐减小,这是因为随着 x 的增加,化合物的电导率逐渐降低,从而载流子对 热导率的贡献减少.通过计算表明,Zn 含量 x 的增 加对化合物的晶格热导率影响不明显.因此,随着 x 的增加化合物的热导率逐渐减小.随着温度的升高, 所有样品的热导率先减小后逐渐增大,在 660 K 附 近达到最小值.这是因为在低温领域(T < 660 K),当 温度 T 升高时,化合物的晶格热振动加剧,从而对 声子的散射作用增强;在高温领域(T > 660 K),由 于本征激发,光学支参与热传导.

下面考察 Zn 掺杂对化合物室温晶格热导率的 影响.用 Wiedemann-Franz 定律 $\kappa_e = LoT(L)$ 为洛沦兹 数 σ 为电导率 ,T 为绝对温度)估算热导率的载流 子部分 ,电导率用实测的数据 ,L 取 2.4 × 10⁻⁸ V²K² ,Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物的晶格热导率通过公 式 $\kappa_p = \kappa - \kappa_e$ 计算得到.计算表明,由于 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物的电导率较低,在总热导率



图 4 Zn 取代量 *x* 和温度对 Ba₈ Ga₁₆ Zn_x Ge_{30-x} 化合物热 导率的影响

 κ 中晶格热导率占主导,当取代量 x = 3 A ,5 ,6 时 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物在 300 K 时的晶格热导率分 别为 1.31 ,1.31 ,1.30 ,1.29 W/mK.所以,随着 x 的 增加化合物的室温晶格热导率有降低趋势.所有化 合物在室温附近的晶格热导率比未掺杂 Ba₈Ga₁₆Ge₃₀ 的文献值(1.4 W/mK)¹⁶¹低,可能是由于掺杂 Zn 原 子产生的晶格畸变对声子产生较强的散射所致.

3.4. Ba₈Ga₁₆ Zn_xGe_{30-x} 化合物的热电性能指数 (ZT值)

根据实测的电导率 σ ,Seebeck 系数 α 及热 导 率 κ ,利用公式 $ZT = \alpha^2 \sigma T/\kappa$ 计算了 p 型 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物的无量纲热电性能指数 ZT



图 5 Zn 取代量 x 和温度对 Ba₈ Ga₁₆ Zn x Ge_{30 - x} 化合物 ZT 值的影响

值,结果如图 5 所示.从图 5 可以看出,所有试样的 *ZT* 值都随温度的升高而增加,并在 800 K 附近达到 最大值.随取代量 *x* 的增加,化合物 *ZT* 值逐渐减 小.所有样品中,Ba₈Ga₁₆Zn₃Ge₂₇化合物在 806 K 处获 得最大 *ZT* 值 0.38.

虽然本文所得到的 Zn 掺杂的 p 型传导 I 型 Ge 基笼合物的无量纲热电性能指数 ZT 值还较低 ,但 通过进一步调整 Zn 含量及 Ga/Ge 的比值以提高载 流子浓度 ,优化其电性能 ,将有可能大幅度提高 ZT 值.

4.结 论

用熔融法及 SPS 烧结合成了单相 $p 型 Ge 基 Ba_8 Ga_{16} Zn_x Ge_{30-x}$] 型笼合物,研究 Zn 的取代量 x 对 $Ba_8 Ga_{16} Zn_x Ge_{30-x}$ 化合物热电性能的影响规律,所

得结论如下:

1)霍尔系数及 Seebeck 系数测试表明,
 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}为p型传导,p型 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}
 化合物的电导率表现为典型的杂质半导体行为,且
 随 Zn 取代量 x 的增加化合物的电导率逐渐降低.

2)p 型 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物的 Seebeck 系数 随 Zn 取代量 *x* 的增加而降低, Ba₈Ga₁₆Zn₃Ge₂₇的 Seebeck 系数在整个测试温度区间内始终最大,室温 Seebeck 系数为 234 μV/K,在 700 K 附近达最大值 295 μV/K.

3)Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物的热导率随Zn取 代量 x 的增加而降低,其中主要以晶格热导 率为主.在所有 p型 Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}化合物中, Ba₈Ga₁₆Zn₃Ge₇₇化合物在806K最大ZT值达0.38.

- [1] Luo P F, Tang X F, Xiong C, Zhang Q J 2005 Acta Phys. Sin. 54
 2404 (in Chinese)[罗派峰、唐新峰、熊 聪、张清杰 2005 物理
 学报 54 2404]
- [2] Liu W S, Zhang B P, Li J F, Liu J 2006 Acta Phys. Sin. 55 645 (in Chinese)[刘玮书、张波萍、李敬锋、刘 静 2006 物理学报 55 645]
- [3] Luo P F, Tang X F, Li H, Liu T X 2004 Acta Phys. Sin. 53 3234
 (in Chinese)[罗派峰、唐新峰、李 涵、刘桃香 2004 物理学报 53 3234]
- [4] Arushanov E , Fess K , Kaefer W , Kloc C , Bucher E 1997 Phys. Rev. B 56 1911
- [5] Tang X F , Zhang Q J 2005 J. Appl. Phys. 97 093712
- [6] Yang L , Wu J S , Zhang L T 2004 Chin . Phys . 13 516
- [7] Okamoto N L ,Oh M W , Nishii T , Tanaka K , Inui H 2006 J. Appl. Phys. 100 073504
- [8] Huo D , Sakata T , Sasakawa T , Avila M A , Tsubota M , Iga F , Fukuoka H , Yamanaka S , Aoyagi S , Takabatake T 2005 Phys. Rev. B 71 075113

- [9] Qiu L Y , Swainson I P , Nolas G S , White M A 2004 Phys. Rev. B 70 035208
- [10] Kuznetzov V L , Kuznetsova L A , Kaliazin A E , Rowe D M 2000 J. Appl. Phys. 87 7871
- [11] Saramat A, Svensson G, Palmqvist A E C 2006 J. Appl. Phys. 99 023708
- [12] Latturner S, Bu X H, Blake N, Metiu H, Stucky G 2000 J. Solid State Chem. 151 61
- [13] Nicolas J, Pierre G, Stanislas P, Bernard C, Michel M, Patrice D, Rodolphe D, Graziella G, Christian C, Michel P 2005 C. R. Chimie 8 39
- [14] Kishimoto K , Akai K , Muraoka N , Koyanagi T , Matsuura M 2006 Appl. Phys. Lett. 89 172106
- [15] Imai M, Nishida K, Kimura T, Yamada K 2002 J. Alloys Compd. 335 270
- [16] Sales B C , Chakoumakos B C , Jin R , Thompson J R , Mandrus D 2001 Phys. Rev. B 63 245113

Synthesis and thermoelectric properties of p-type Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30 - x} clathrates *

Deng Shu-Kang Tang Xin-Feng[†] Zhang Qing-Jie

(State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China) (Received 14 November 2006; revised manuscript received 22 January 2007)

Abstract

Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x}(x = 3, 4, 5, 6) clathrates with different Zn contente were synthesized by melt method reaction and spark plasma sintering. The effect of Zn composition on the thermoelectric properties were investigated. The results show that all samples behave p-type conductor. The electric conductivity and room-temperature carrier mobility decrease with increasing Zn content, and the room-temperature carrier density N_p increases with increasing Zn content. Of all p-type Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x} compounds, Ba₈Ga₁₆Zn₃Ge₂₇ has the highest Seebeck coefficient, the value of which is 234 μ V·K⁻¹ at 300 K, and reaches as high as 295 μ V·K⁻¹ around 700 K. The thermal conductivity of Ba₈Ga₁₆Zn_xGe_{30-x} decrease with increasing x. The maximum ZT value of 0.38 is obtained at 806 K for Ba₈Ga₁₆Zn₃Ge₂₇.

Keywords: p-type clathrates , synthesis , thermoelectric properties **PACC**: 8120 , 7215 , 7430F

^{*} Project supported by the Major International Cooperation Program of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50310353) and the Cultivation Foundation of the Major Program of the Scientific and Technical Innovation of Ministry of Education , China (Grant No. 705035).

[†] E-mail :tangxf@whut.edu.cn